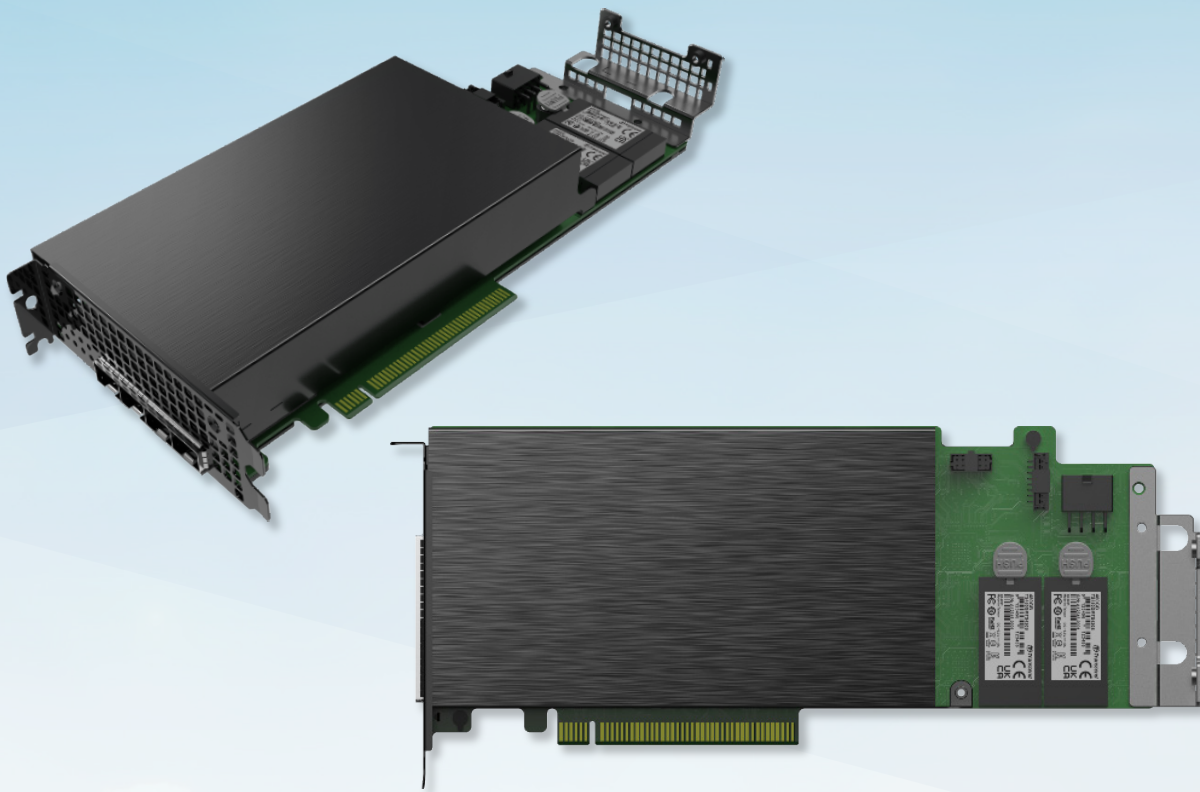


华为全自研SP900系列DPU卡



高性能

算力高

- 集成24核自研处理器芯片

性能领先

- 大数据查询性能提升40%
- 裸金属服务秒级发放*



高可靠

数据双备份

- 最多2个M.2 SSD盘，满足电信级高可靠性

硬件自监控

- 板载MCU硬件状态监控
- 硬件自检保障硬件可靠运行



易编程

编程灵活

- 开放DPAK，兼容智能网卡和DPU
- 提供北向标准生态接口，易集成

多场景加速

- 提供网络加速、存储加速、计算加速等SDK加速能力



易运维

运维高效

- 自研管理工具和带外管理功能，全量管理DPU卡

应用场景



运营商

网络云NFV、IT云等



金融

金融大数据、裸金属场景



安平

大数据



互联网

裸金属场景

*秒级发放：指的是从系统云盘挂载完毕到主机出现BIOS热键界面的时间小于60s

技术参数

功能	SP923Q
网络接口	4*25G
主机接口	PCIe4.0 x16, 兼容PCIe 3.0, 兼容x8/x4
处理器	华为海思Hi1822处理器 (24 cores)
内存	内部支持4通道DDR4-2400MT/s ECC内存, 内存容量32GB
存储	2*64GB NVMe M.2 SSD, 作为OS启动盘 双盘支持RAID 1 (出厂默认不组RAID, RAID 1需要客户基于选择的OS自行做配置)
系统管理	Huawei iBMC: 服务器BMC管理接口, 支持SNMP、IPMI, 提供GUI、硬件监控等特性
安全特性	借助华为服务器iBMC安全特性, 包括管理员密码、机箱开盖事件记录。 面板安全, 拆卸需要开箱
通用功能	通用: 支持IPv4/IPv6 支持PF单播列表过滤、组播列表过滤、混杂模式、全组播模式 支持VLAN 支持BIOS下端口界面配置 支持jumbo frame 支持PFC 支持流控风暴检测与抑制 支持ETS 支持LLDP协议 支持环回测试 支持多队列 支持RSS分流 支持队列个数管理 支持队列深度管理 支持FDIR基于流定向到指定队列 支持光模块管理 支持中断聚合参数配置 支持中断聚合参数自适应 支持速率自适应 支持速率自协商 支持修改MTU 支持端口点灯 支持端口bonding 支持网口复位 硬件加速: 支持TSO/LRO卸载 支持UDP/GSO (卸载) 支持GRO/LRO卸载 支持VLAN卸载 支持TCP/UDP/IP Checksum卸载 运维管理: 支持NC-SI 支持MCTP over PCIe 支持带外方式获取芯片日志 支持网卡管理CLI工具 支持安全启动 支持UEFI下PXE 支持MAC层错误报文检测 支持IP层错误报文检测 PF支持查询光模块信息 PF支持查询link失败原因 PF支持异常中断恢复处理 支持link失败快速上报 PF支持设备PM暂停或恢复 PF支持光模块管理 支持固件安全升级
高级功能	裸金属: 网络和存储卸载
尺寸 (长宽高)	全高3/4长双槽位: 282.5mm × 126.4mm × 40.6 mm
工作环境	工作环境: 5° C~55° C, 8% RH~90% RH非凝结 存储环境度: -40° C~+65° C, 5% RH~95% RH非凝结
工作电压	8A@12V以上供电

如需了解华为全自研SP900系列DPU卡的更多信息, 请联系华为销售代表或业务合作伙伴

© 华为技术有限公司 2024。

保留一切权利。本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺



华为计算公众号